

2019年1月15日

各位

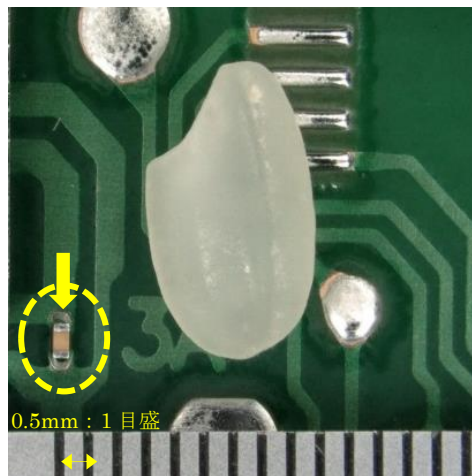
会社名 株式会社 京 写  
代表者名 代表取締役社長 児嶋 一登  
(コード番号 6837)

問合せ先 執行役員 人事総務・経理財務担当平岡 俊也  
(TEL 075-631-3193)

業界初！ スクリーン印刷法による 0603 チップ部品サイズに対応可能な  
片面プリント配線板を開発しました。

株式会社京写（京都府久世郡久御山町森村東 300 番地 代表取締役社長児嶋一登）は、従来から開発を続けていた『スクリーン印刷法による微細パターン形成技術』をベースに、0603 ランド形成が可能となる『高精細スクリーン版』と『インク』を開発しました。

また、高精度にレジストインクを塗布できる独自の『位置合わせ工法』を組み合わせることで、従来は高価な写真法でしか対応できず、開発が急務となっていた『スクリーン印刷法による 0603 チップ部品に対応可能な片面プリント配線板』の供給に、実現の目処が立ったことをご報告いたします。



左下破線囲い部分が 0603 サイズのチップ。

業界初となる『スクリーン印刷法』での超微細な 0603 チップ部品の実装搭載基板を実現することで、従来の写真法と比べて低価格な片面プリント配線板を提供できることに加え、電子機器の更なる小型化、低ノイズ化に貢献できます。

#### 【製品化時期】

本製品は 1 月に開催されるインターネットコンジャンプで公開いたします。また、2019 年 1 月より、順次国内外工場ですべての受注を開始する予定です。

※・・・電子機器の小型化、高性能化に伴う部品の小型化要求により、積層セラミックコンデンサ（MLCC）はその主流が 1005 サイズ（1.0×0.5 mm）から 0603 サイズ（0.6×0.3 mm）に急速に移行しつつあり、スクリーン印刷法による片面プリント配線板の開発が急務となっていました。

以上